



Imprimación a base de cobre

TSP 530

- Imprimación de resina de acrilato de base de cobre que ofrece protección anticorrosiva contra el óxido por aplicaciones con sistemas de soldaduras SPOT, MIG & TIG
- Alta concentración de cobre que crea una película de secado rápido para acelerar el proceso de soldado con un mínimo impacto en la soldadura
- Tiene excelentes propiedades adhesivas.
- El producto puede ser utilizado antes y después de soldar.
- La imprimación de cobre puede ser repintada con la mayoría de los sistemas de pintura.

code	Descripción	Caja	Pal
TSP 530	Primario Para Soldar a Base de Cobre 400ml	12	672

